

プラズマ・サーモ・ジャパン株式会社

プラズマ技術～低温洗浄・均一薄膜形成への応用

第84回応用物理学会秋季学術講演会ランチオンセミナー

「高アスペクト比トレンチ・ビアの低温洗浄と均一膜形成技術の紹介」

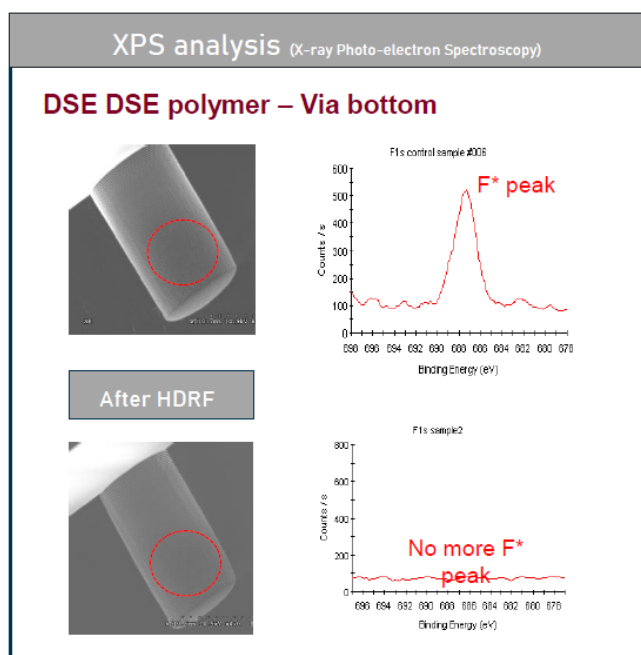
多くの半導体デバイスは、高アスペクト比トレンチ・ビアを必要とし、使用される形成技術は、ボッシュプロセスや、標準的な ICP-RIE になります。更に、高アスペクト比構造は、その後のプロセスをより一層難しくさせます。例えば、ボッシュプロセスの場合、スカロップの処理やフッ素系ポリマー除去。また、成膜例では、成膜速度が速いプラズマCVDは、コンフォーマリティが低く、コンフォーマリティが高いALDでは成膜速度が遅いといった課題があります。

今回は、これらの課題を解決する、弊社の独自低温クリーニングのプラズマ技術（HDRF）および高速連続原子層堆積のプラズマ技術（FAST）をご紹介します。

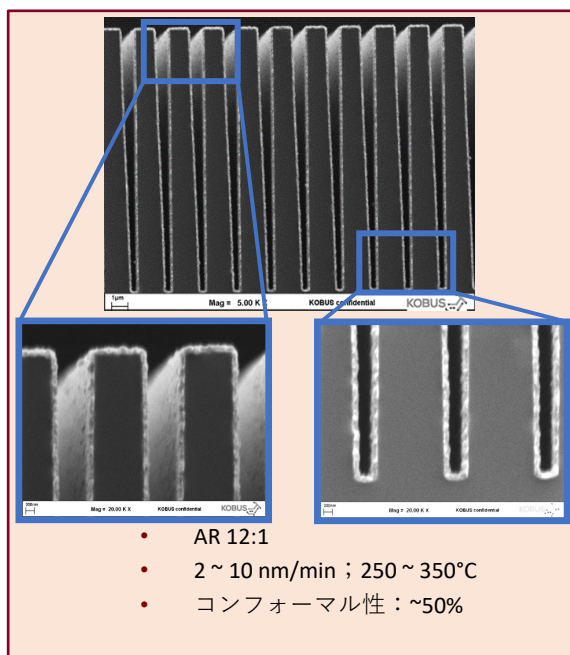
■ 日時: 2023年9月20日(水) 12:15～12:55

■ 会場: A307

HDRF：フッ素及びポリマー除去例



KOBUS FAST：TiN 成膜例



Plasma-Therm